

# 半導體技職班

開課時間：114年5月8日至5月28日

報名截止日：114年4月14日

授課語言：西語



1

## 訓練簡介

為呼應榮邦八大旗艦計畫之「半導體供應鏈韌性」主軸，協助友邦培育科技產業所需人才，本班課程內容將介紹完整半導體產業鏈知能，如 IC 設計、製程與封裝測試等，並安排電路模擬及產線實務演練，協助學員掌握從元件基礎到操作應用之關鍵環節。

## 課程安排面向

- 半導體概論與 IC 設計：半導體元件原理及基礎概論、電路模擬軟體 (LTspice) 介紹及 IC Layout 實驗等，讓學員初步熟悉晶片設計流程。
- 半導體製程與封測技術實作：介紹材料特性、IC 製程（氧化、沉積、微影、蝕刻）及封裝技術，運用 Silvaco 元件模擬軟體進行實作，並安排封裝與測試產線操作，使學員直接接觸實際生產流程。
- 半導體產業鏈參訪：安排我國半導體產業鏈上中下游相關企業實地參訪。

## 參訓資格

- 年滿20歲以上，具電機、電子或基礎電路知識，對半導體技術應用有興趣者。

### 課程聯絡人

許禮筠 副管理師

Tel: 886-2-28886090

Fax: 886-2-28766491

E-mail: L.y.hsu@icdf.org.tw

TaiwanICDF School



A Sneak Peek of  
TaiwanICDF Workshop Program